



警告 告

本手册□供有□□的□修人□使用,不适用于一般消□者,手册中没有□非技□人□企□□修本□品
而存在的潜在危害提出警告或提醒。□器□品□由有□□的□□技□人□□行□□和修理,任何其它人企
□□本手册涉及的□品□行□□和修理将有可能受到□重□害甚至有生命危□。

1 □品□述

1.1 □源概述

本口源由 PI(Power integrations))所提供的芯片口开口平台,是一款通用于 46/47 背光屏 (CCFL) 的 LCD 口源.在此口源方案中将所使用到的主芯片有如下:

PLC810PG PFC&LLC 二合一芯片

TNY175PN 待机芯片

1.2 主要功能

此液晶□源□入□□范□□ AC110~250V(最低 110Vac ,最高 250Vac),□出□□情况□ 5V/0.6A、24V/10A(背光)、24V/1.5A(功放)、12V/3A 四□直流□源。

1.3 主要技□□格

5V/0.6A、24V/10A(背光)、24V/1.5A(功放)、12V/3A

2 □路介□

机芯□路介□

本□源板□路大致由四大部分□成.

- 1. 市□□入□路与整流□波□路。由□感□容□成的低通□波器□成。
- 2. PFC(功率因数校正)校正□路和 LLC 主□路,由 PI 公司提供的二合一集成芯片□□

□出+24V(背光), +24V(伴音), +12V



3. 待机□路。

副□源(+5V 待机开关□□□路);由PI 公司的 TOP253EN □成。

此□路□反激式□路,集成了开关管 MOSFET 管,□集成□。

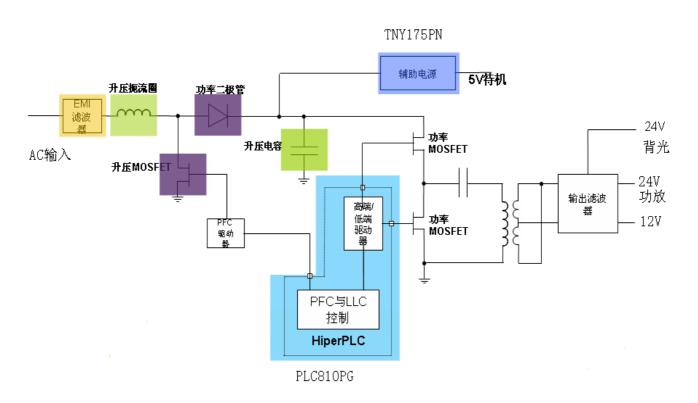
4. 各控制□路□出□整流□□□路。

□出整流□路由复合□极管□成的全波整流□路。



3 主要信号流程介□

3.1 信号流程□



3. 2基本工作□程介□

A:市□□由CXP00/LP00/CXP01/LP01/CXP02/LP03/THP01/THP02/BRP00等□成的整流□波□路后□□成脉□直流□□,□整流后的□□分别送□后面两路独立的开关□□□源,□路□待机□路,□路□PFC□路升□后再□主□路。

由 UP00(PFC部分)/LP06/QP00/DP01 等□成的 PFC □路, □□ DP01 整流, CP04 □波后□出□ 390V-400V 直流□□。

B:□式整流后的□□, 再□ DP11/DP17整流后提供□待机□路(UP01/DS06等)□生+5V□出□□, 此□□供液晶□□ CPU控制□路、USB□路、遥控接收□(用以控制遥控开关机,□□待机功能)。

C: 主□路□出:由UP00(LLC部分)和主□□器 T600、□出□肖特□二极管
DS03/DS02/DS00/DS01 共同□成主□路,□出 24V/10A(供背光板), 24V/1.5A(伴音□路)、
12V/3A(主板/□□板)。



4 主要芯片介□

4.1 芯片

4.1.1 芯片概述

HIPERPLC810PG

HIPERPLC810PG集PFC及LLC周□式控制器与集成高□□半□□□器于一体。□1所示□采用PLC810PG器件的□源□构□□,其中LLC□振□感集成在□□器中。PLC810PG的PFC部分采用无需正弦信号□入参考的通用□入□□□流模式(CCM)□□,从而减少了系□成本和外部元件。DC-DC控制器□□LC□振拓扑。□个□□控制器可使MOSFET在零□□□□行开关操作,从而消除大部分的开关□耗,提高效率。LLC控制器的核心是一个□流控制的振□器,其□率控制范□支持□□机□源的□□工作□率。□了确保零□□开关,PLC810PG中LLC开关的死区□□被□格控制在容差范□之内,并可通□一个外部□阻□行□□。高低□两端的占空比□密匹配,以提供平衡的□出□流,从而降低□出□极管的成本。典型PLC810PG LLC□□的工作□率□100 kHz(在□定工作条件下)。□LLC□路的□□而定,开关□率可以是□定工作□率的二分之一到三倍不等,□与□入□□和□□□化有关。PFC□□器的□率□定于LLC,以降低噪音和□磁干□。在□□□提高PFC□率与LLC同步可降低PFC升□□□器在□□□非□□模式□的□流,从而改善□□工作状况和降低□源□□波。□□□□提供PFC和LLC初□□故障管理功能。可根据LLC相位□PFC PWM□出相位□行□□□□,以便于开关沿与PWM和LLC□序□路中的噪音敏感部分不相交。避免□□冲突技□可□化□源布板并提高性能。相位同步可降低EMI□□成分和PFC□容的□波□流。

TNY175PN

TinySwitch-LT集成了一个650 V的功率 MOSFET、振□器、高□开关□流源、□流限流(用□可□)及□ 关断□路。IC □品系列采用开/关控制方式,提供一个灵活的□□方案,并且□□更低的系□成本及更大的□出功率范□

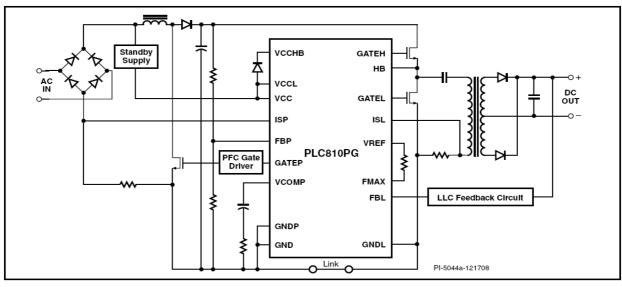
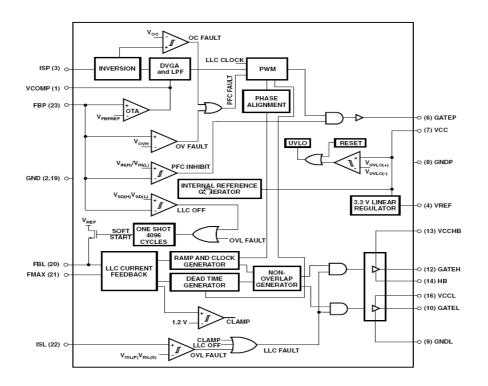


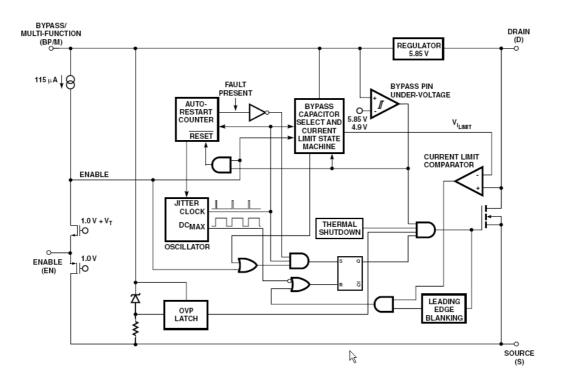
图 1. 典型应用电路 — LCD电视机电源

PLC810PG

4.1.2 芯片内部框□



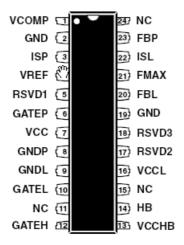
PLC810PG



TNY175

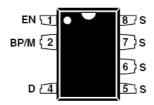
4.1.3 芯片管脚□

PLC810PG



TNY175

P Package (DIP-8C)



4.1.4 芯片重要引脚功能及□□工作□□

PLC810PG

VCC引脚

VCC

VCC□IC中的弱信号模□□路供□。必□在VCC引脚和GND引脚□□接一个旁路□容。□□容□□□10 μF 的陶瓷□容,或者是一个10 μF□解□容与一个0.1 μF陶瓷□容的并□□合。

VCCL

VCCL是LLC低□端□□器的供□□入引脚。它□□LLC低□端MOSFET□□器以及模□□路与LLC□□器
之□的通信□路供

□。必□在VCC引脚和GNDL引脚之□□接一个1 µF的陶瓷旁路□容。□□容可提供瞬□□流用来□通LLC 低□端MOSFET

栅极。

VCCHB

VCCHB是LLC高□端□□器的浮□供□□入引脚,以HB引脚□参考。反□来,HB引脚又□接到LLCMOSFET半□中心点。必□,且必□在VCCHB引脚到HB引脚之□□接一个1 μF的陶瓷旁路□容。□□容可提供瞬□□流以□通LLC高□端LLC

MOSFET的栅极。



在典型□用中,VCC与待机□源相□。VCCL□通□一个5 Ω□阻□接到VCC引脚,□□可以□防噪音。
VCCHB通□一个高□二极管与一个5 Ω□阻□成的串□□路□接到待机□源。一旦LLC低端MOSFET□通,此二极管与□阻□合将□1 μF的退耦□容充□。□阻限制峰□瞬□充□□流。□□4中的R42和D8。

GND引脚

GND

GND是所有模□弱信号的返回□点。所有弱信号引脚旁路□容必□通□短接□□接到□引脚。□引脚必□有 一个□点□接,

并通□□用走□□接到PFC□流□□□阻,同□□□阻又必□放置在PFC MOSFET附近。禁止将□引脚□接到PFC/LLC□□□路中的任何其他□接点。VCC旁路□容也必□□接到□引脚。

GNDP

GNDP□□PFC栅极□□信号的返回引脚。□引脚必□直接□接到PCB上的GND引脚。

GNDL

GNDL□□LLC低□端栅极□□器的返回引脚。必□通□一条□用走□和一个小的□氧体磁珠将□引脚□接到LLC低□端

MOSFET源极引脚。□引脚必□□由一个1 Ω□阻□接到GND引脚,□□可以□防噪音。VCCL旁路□容也必□返回到□引脚。

其他引脚

HB

半□引脚。□引脚是LLC高□端MOSFET□□器的返回引脚。必□将□引脚□接到由LLC MOSFET□成的半□中心位置。

VCCHB旁路□容也必□返回到□引脚。

ISP

□流□□, PFC。它用于□□□流□□□阻上的□□□(可描述PFC□感□流)。□□□□阻□接PFC

MOSFET源极和□"-"端子。信号必□穿□□□常数介于100到200 ns之□的RC低通□波器。由于ISP引脚要



求有内部偏移□流,因此□阻不得大于150 Ω。平均□感□流(□□数个开关周期□得)用于PFC控制算法。 □引脚也□行逐脉冲□流限制功能。

ISL

□流□□, LLC。□引脚用于□□□□器初□□流,可□□LLC□□情况。□将它□接到LLC低□端
MOSFET源极引脚和□

□器初□□低部之□所□接的□流□□□阻。信号必□穿□□□常数介于200 ns到1 μs之□的RC低通□波器。低通□波器中的□容必□□接到GND引脚。流限有两个□别,□低及□慢的一□是用于□出□□,□高及□快的一□用于元件故障保□。

低通 \square 波器中的串 \square \square 阻 \square \square 1 k Ω 或更大,以限制流入ISL引脚的 \square 流。

GATEP

PFC MOSFET栅极□□□路的栅极□□□出信号。

GATEL

低口端LLC MOSFET的栅极口口。

GATEH

高□端LLC MOSFET的栅极□□。

VREF

LLC反□□路的3.3 V参考引脚。必□□接一个1 uF的陶瓷退耦□容,且从VREF引脚到GND引脚□行走□。

FBP

反□PFC引脚□接到用于□□PFC□出□□的外部□阻分□器。□是跨□放大器的同相□入。跨□放大器□ 出□接到

VCOMP引脚,反口口口也口接到口引脚。必口在FBP引脚到GND引脚之口口接一个10 µF的退耦口容。

VCOMP

□引脚是PFC反□□路元件的□接点。引脚上的□□用作PFC控制器乘法器的□入。此引脚的□定□性□□ 范□□0.5 V到2.5V,其中,□□越高,表明功率越小。

FBL

LLC反口引脚。□入口引脚的□流可确定LLC开关□率。它有一个□定□□和□阻分别□0.65 V和3.3 kΩ的 戴□南等效□路。



FBL必□用一个1 μF的□容退耦到GND引脚。注意,□□容与□入□阻形成了一个点。

FMAX

□引脚通□一个□阻与VREF相□,用于□定LLC的最大□率。如果FBL引脚□流所需的□率超□最大□定□率的95%,LLC高低□两端的□□器将会同□关断两个LLC MOSFET。□引脚必□用一个1 μF的□容退耦到GND引脚。

RSVD1, RSVD2, and RSVD3

RSVD1必□□接到VREF。RSVD2和RSVD3必□□接到GND引脚。

TNY175

旁路/多功能(BP/M)引脚:

□引脚有多□功能:

- 1. 一个外部旁路□容□接到□个引脚,用于生成内部5.85 V的供□□源。
- 2. 作□外部限流点□定,根据所使用□容的数□□□□流限流□。使用数□□0.1 ∝F的□容会工作在□准的□流限流□上。使用数□□1 ∝F的□容会将□流限流□降低到相□更小型号的□准□流限流□。使用数□□10 ∝F的□容会将□流限流□增加到相□更大型号器件(TNY175-180)的□准□流限流□。
- 3. 它□提供了关断功能。在□入掉□□,当流入旁路引脚的□流超□Iso□关断器件,直到BP/M□□下降到4.9 V之下。□可将一个□□管从BP/M引脚□接到偏置□□供□端□□□出□□保□。

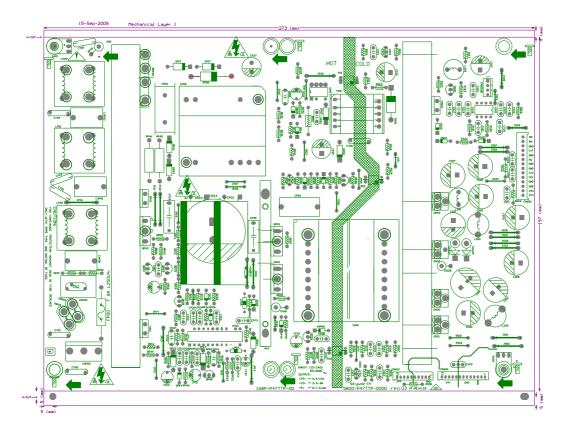
使能(EN)引脚:

功率MOSFET的开关由此引脚控制。当从此引脚拉出的□流大于某个□□□流□,MOSFET将被关断。当此引脚拉出的□流小于某个□□□流□,MOSFET将被重新开启。□□□□流的□制可以防止群脉冲□象的□生。□□□流□在75 ∝A到115 ∝A之□。

源极(S)引脚:

内部□接到 MOSFET 的源极,用于高□功率的返回□点及控制□路的参考点。……

5 PCB □□□印



6 □□□明

6.1 □气特性

1	□入特性			
序号	□目	技□要求	□位	□注
1.1	□定□入□□	110-220	Vac	
1.2	□入□□范□	110-240	Vac	
1.3	□入最大□流	5	А	
1.4	效率	≥85%		220Vac, (□定□□)
1.5	交流□入□□□率	50-60	Hz	□定□入□□, □境温度 25℃
1.6	□入浪涌□流	≤100	А	冷机状□
1.7	功率因数	有源 PFC		
2	□出特性		•	
序	予 □ 目	技□要求 □格	-	□ 注

机芯口修手册

D C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	号		+24 V(背 光)/+24 V(功放)	+12V	+5V	□位	
2.3	2.1	□出□流范□	0-10/0-1.5	0-3	0-0.6	А	
25.2/22.8 25.2	2.2	□出峰□□流	6/1.5	5	3	Α	
2.5	2.3	□出□□范□	25.2/22.8-	11.4-12.6	4.9-5.25	Vdc	
2.6 □出□波 ≤240 ≤120 ≤50 mVp-p p	2.4	□□□整率	5%/5%	5%	5%	%	
2.7 □出噪音	2.5	□□□整率	5%/5%	5%	5%	%	
2.7	2.6	□出□波	≤240	≤120	≤50	·	□定□入,□出□ ⁻ □,20MHz □□, □ □ 端 并
始工作。□出+24V和+12V在收到待机信号(低□平)后,完全关断主□源,只保持副□源(+5V)的□出。 2.9 待机功耗		·	/	/	/		104+10μF□容
3 □序	2.8	上□、掉□□序 	始工作。□出+ 平)后,完全关	24V 和+12V 在收到	· 削待机信号(低□		
3.1	2.9	待机功耗	待	待机□□功耗≤1.0W			
□整范□内	3	□序					
4 保□特性 4.1 □出□□保□ +24V 30.0 Max 4.2 □出限流保□ +24V 12.0 Max A 4.3 □出短路保□ □源保□ 后会□定 故障去除后需重新 插拔AC□ 入,□源才 其它□出□□	3.1	开机延□)Vac,□□, □出	岀□□□保持在		≤3Sec
4.1 □出□□保□ +24V 30.0 Vdc 4.2 □出限流保□ +24V 12.0 Max A 4.3 □出短路保□ □源保□	3.2	保持□□			C, 口口, 口出		≥8ms
4.2 □出限流保□ +24V 12.0 Max A 4.3 □出短路保□ □源保□	4	保□特性					
4.2 □出限流保□ +24V 12.0 Max A 4.3 □出短路保□ □源保□ 后会□定 故障去除 后需重新 插拔AC□ 入,□源才 其它□出□□	4.1	□出□□保□		+24V			Vdc
后会口定 故障去除 后需重新 插拔AC口 入,口源才	4.2	□出限流保□	+24V	12.0	Max		
	4.3	□出短路保□	后会口定 故障去除 后需重新 插拔AC口 入,口源才	插拔周期大于 2S			其它□出□□





安□及 EMC 特性

序			技□要求	□注
号				
1	抗	□入□□出	3000Vac/10mA/10min	无□穿、□弧□象
				(本机□出接大
	强			地)
	度			
2	2 通□□□		3С □□ ОК	已送广州 5 所,口
				□ OK
3	3 □射□磁□(RS)		LEVEL 3:10V/m □强	EN55022
				CLASS B
4	□射	□□感□的□	LEVEL 3:10V/m □强	EN55022
	ロ干	□ (CS)		CLASS B

6.2 生□中的特殊工□要求

无



7 □修□明

7.1 常口故障分析与注意事口

□修□要与案例

1. 修理前先用目□和鼻□两种方式,仔□□察整个不良板有无□器件,□坏器件、元器件虚漏□等□

象.

然后口行如下的几个流程开始口修口:

A:有无5V待机口出。

B:有无待机控制高□平,待机控制□平需要高于3.3V。

C: 有无+12V, +24V(背光), +24V(功放)□出。

2. □修范例流程示意□



- □□□入通道。使□入通道保持通
- □。□□L/N端至□堆交流□入脚是 否□通,□堆BRP00有否短路□穿
- □象,有□更□□坏物料。

无

□□芯片内置MOS漏□(芯片7脚)

有无数百伏交流口口,即判断芯 片是否起振,从而口一步判断芯片

TNY175□坏情况, 更□芯片。

□□控制芯片周□的元器件是否有短路,

开路□象,虚□情况。□□步□:

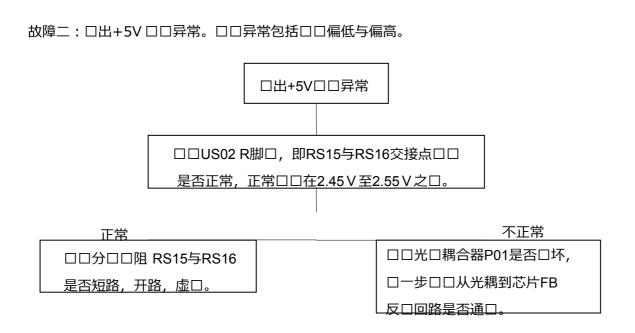
- 1、□□吸收□路CP24/RP51和DP07
- 2、□□TL431反□回路P01/US02等
- 3、□□□出有没有短路CS16或CS17

有

有

排除虚□开路情况。如果器 件短路□更□□坏元器件。







故障三:有正常的□出5V□□,但没有PFC□□(380V~400V)□出

		常,没有PFC□ //12V□出□□。
	│ □□有无待机控制□ ³	平(ENABLE信号)□来,
	待机控制口平口高口	平启口,启口口口大于
	3.3V,可□□□□阻RS1	9(靠JS08端)。
有		□□保□□路控制芯片处于7542,□量
1/11WC [÷+====	第
十月四十二	主板□□	3脚,正常□□低□平,如高□平□保
		□路工作,□□保□□路,排除□保
		\Box .

注:芯片WT7542集成待机□平控制□路和24V/12V□流、□□保□□路。

芯片引脚功能和具体功能口口方式如下:

芯片1脚 VCC 脚 5V 供口

芯片 2 脚 PSON 脚

芯片 3 脚 FPOB 脚

芯片4脚GND脚



芯片 5 脚 IS24 脚	(24∀/背光 □	1流口口脚)
	\ <u>_</u>	ᄀᄭᄔᅜᆜᄓᄭ

芯片 6 脚 VS24 脚(24V/背光 □□□□脚)

芯片 7 脚 IS12 脚(12V □流□□脚)

芯片 8 脚 VS12 脚 (12V □□□□脚)

芯片 2 脚(PSON 脚)□□到 POWER ON 信号后,3 脚□出低□平控制光耦 P02 二次□□光二极管□通,二次□光敏三极管□通,QP06/CP03/VRP00/RP29 □成的精密□□□路□出 VCC 供 PLC810PG 供□。□路工作正常。反之待机□,芯片 2 脚没有控制信号,3 脚□出高□平,光耦 P02 截止,卡断 VCC 供□。□路停止工作。

7.2 机芯配用通用功能模□

序号	通用功能	通用功能模	开□□□所	开口口口口	□系□□	□系□箱
	模□名称	□□号				
1	47K10		平板一所	江口		
2	47K06		平板二所	柳如峰		

.

7.3 端口及口口定口

交流□□入:

PIN	Signal	describes
1	AC	AC (L)
2	GND/NC	GND/NC
3	AC.	AC (N)

屏供□ (10 PIN×1) 、 (13 PIN×1)

(10 PIN×1)



面朝端子缺口,从左至右依次为PIN1-PIN10。

PIN	Signal	describes
1	+247	+247
2	+247	+247
3	+24V	+24V
4	+247	+247
5	+24V	+24V
6	GND	GND
7	GND	GND
8	GND	GND
9	GND	GND
10	GND	GND

(13 PIN×1)

面朝端子缺口,从左至右依次□ PIN1-PIN13

ΡI	Singal	Describes
N		
1	+24V	+24V
2	+24V	+24V
3	+24V	+24V
4	+24V	+24V
5	+24V	+24V
6	GND	GND
7	GND	GND
8	GND	GND
9	GND	GND
10	GND	GND
11	GND (□	GND (□
	光)	光)
12	BL-	BL-
	ADJUST	ADJUST
13	BL-	BL-
	ON/OFF	ON/OFF

主板供□接口(14 PIN×1)

面朝端子接口,从左至右依次□ PIN1-PIN14

PΙ	Singal	Describes
N		
1	+24V(伴音)	+24V
2	+24V(伴音)	+24V
3	GND	GND
4	GND	GND
5	+12V	+12V
6	+12V	+12V



7	GND	GND
8	GND	GND
9	+5V	+5V
10	GND	GND
11	ON/OFF	ON/OFF
12	GND	GND
13	BL-ADJUST	BL-ADJUST
14	BL-ON/OFF	BL-ON/OFF

7.4 关□元器件及□□修□件清□

序号	物料□号	物料型号	位号	名称/功能	代用物	口注
				/参数	 料□号	
1	4785-P81000-	PLC810P	UP00			
	0240	G				
2	4785-T17500-	TNY175P	UP01			
	0800	N				
3	4600-K35280-00	2SK3528	QP01/QP	600V/17A		
			02			
4	4600-K28370-00	2SK2837	QP00	500V/20A		
5						
6						
7						
8						

7.6 机芯存□、运□、使用条件

1、包装

包装箱上有□品名称、型号、□□、□量部□的□□合格□、制造日期等。

2、运□

适□于□、船、□机运□,运□中□遮蓬、防晒、文明装卸。

3、□存



□品未使用□□存放在包装箱内,□□□□境温度□-40℃-55℃,相□湿度□ 10%-95%,□□内不允□有有害气体,易燃,易爆的□品及有腐□性的化学物品,并且无强烈的机械振□,冲□和强磁□作用,包装箱□□离地至少 20cm 高,距离□壁、□源、窗□或空气入□至少50cm,在本□定条件下的□存期一般□ 2 年,超□ 2 年后□重新□行□□。